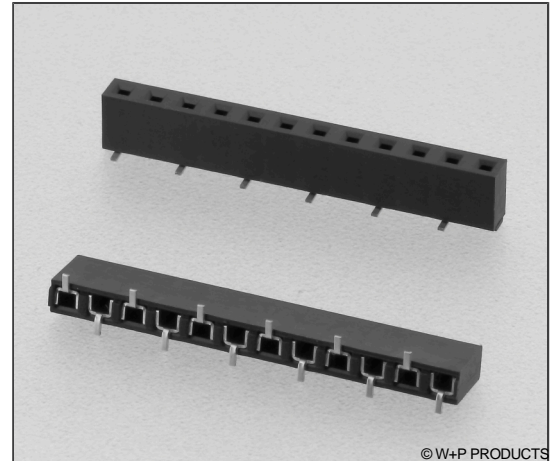


## SMT-Buchsenleisten RM 2,54mm, stehend, 1-reihig – BH 5,0mm, durchsteckbar SMT Female Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Single Row – 5.0mm Profile, Pass Through

### Technische Daten / Technical Data

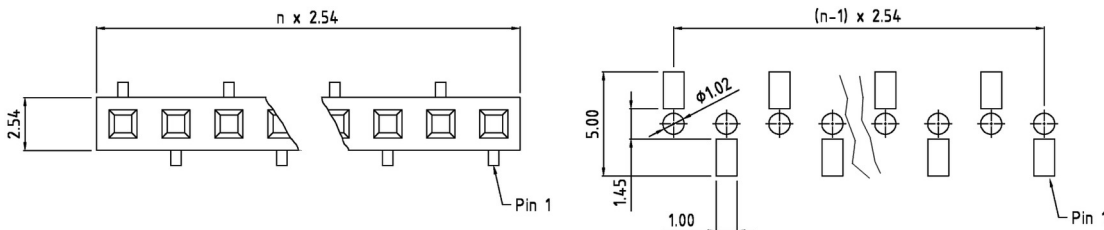
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



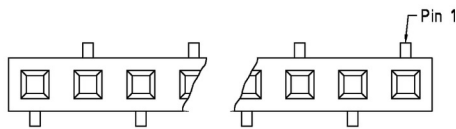
© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,635mm.  
Dual beam contacts accept 0.635mm square pins.

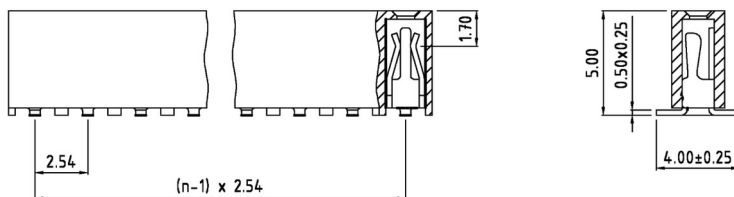
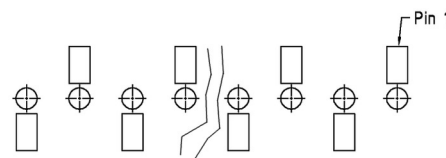
### Type B1



### Type B2



### PCB Layouts



### Series

**3498**

### Contacts\*

**10**

03-40 Einreihig  
Single row

### Type\*

**2**

1 Layout B1  
2 Layout B2

### Plating\*

**50**

00 Vergoldet  
Gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated  
60 Sel. Au/Sn  
Duplex plating

### Packaging\*

**PPTR**

ST  
PPST  
PPTR

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

